

泰凌微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：泰凌微

证券代码：688591

编号：2025-006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	通过上证路演中心网络互动参与 2024 年度科创板人工智能及软件行业集体业绩说明会的投资者
时间	2025 年 4 月 29 日 15:00-17:00
地点	上海证券交易所上证路演中心 (网址： https://roadshow.sseinfo.com/)
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：盛文军 副总经理、董事会秘书：李鹏 财务总监：边丽娜 独立董事：刘宁
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、互动交流问答主要内容如下（已合并相似问题）：</p> <p>Q1：可以对 2025 年公司的业务做一个展望吗？</p> <p>A1：2025 年，公司将持续研发具有自主知识产权且达到国际一流水平的低功耗无线物联网系统级芯片，以满足市场需求、赢得客户认可。</p> <p>在销售方面，继续拓展 IOT 垂直市场，进入高端游戏配件品类，拓展智能电动车市场，持续大批量出货；同时更加灵活的应对国内行业内卷业态；继续保持无线音频产品线的高增长；WiFi 产品实现批量出货；</p> <p>研发方面，持续加速内部的研发节奏，并进一步布局 AI 相关基本能力和应用；进一步加大 22nm 等先进工艺布局，完善产品矩阵，加大研发层面芯片成本优化和性能提升；</p> <p>市场推广方面，继续大力拓展海外市场，持续覆盖美国、欧洲和亚太区域在内的全球市场，增强欧美和亚太市场的媒体覆盖，积极参加重大国际展会，挖掘高潜力细分市场机会，并进行针对性的市场推广，紧跟技术前沿，与各行业联盟和标准组织保持密切互动，加强行业领导者形象，提升品牌在行业内的影响力。</p> <p>Q2：公司近期的订单情况如何？变化原因是否受 AI 带动？</p> <p>A2：2025 年一季度，公司销售额实现同比高增长，受益于下游行业数字化和智能化渗透率的持续提升，公司在物联</p>

	<p>网连接市场（智能家居、ESL、办公等）及音频市场的主要客户和新增客户的出货量都有显著提升；此外，一些新开拓的垂直市场如智能储能 BMS、智能网关等也贡献了新的销售额增长；公司的几个新产品包括端侧 AI 芯片等都开始了批量出货。</p> <p>Q3：芯片、中间件等基础技术领域是否面临“卡脖子”风险？供应链国产化率现状如何？</p> <p>A3：公司高度重视与供应商之间保持良好且紧密的业务合作关系，以确保公司芯片产品在客户端按时、保质、足量交付。公司与全球领先的晶圆厂商、封装测试厂商已建立稳定的业务合作关系，能有效保障公司业务稳步增长的产能需求。在供应体系上公司拥有中芯国际、台积电这样的全球龙头企业，拥有灵活完善的，可以覆盖全球范围的供应链体系。对于全球不同区域，不同要求的客户均可以合理覆盖，成为客户可以信赖的合作伙伴。</p> <p>公司与全球范围内供应商保持长期良好的合作，积累了丰富的供应链管理经验和有效保证了产业链运转效率和产品质量，降低了行业产能波动对公司产品产量和供货周期的影响，同时，亦可积极应对当下复杂多变的国际贸易环境以及关税政策调整等。此外，公司也积极协同上下游产业链进行资源整合，将市场和客户对新产品的需求及时反馈给供应商，双方合作进行工艺提升或者生产流程管控从而进一步提高产品的性能和质量。</p> <p>此外，公司在产品中积极拥抱开源的 RISC-V 架构指令集，是低功耗 IOT 领域最早采用 RISC-V 架构 MCU 的芯片公司，目前已经形成了丰富的基于 RISC-V 架构处理器的芯片产品矩阵，RISC-V 架构在指令集的自主可控性、芯片架构的可拓展性和芯片成本的可优化性方面均具有明显优势。</p> <p>Q4：公司星闪芯片与端侧 AI 芯片已支持低延时（20μs 级）多设备协同，而国际星闪联盟 4 月刚与全国机器人标委会达成战略合作。请问在具身智能机器人领域，公司如何规划星闪+AI 芯片的协同效应？是否会针对机器人本体感知与群体协作推出专用解决方案？公司端侧 AI 芯片具备超低功耗与边缘计算能力，而深海装备对水下通信和能源效率有严苛要求。请问在深海资源开发、海底观测网等国家战略方向，现有技术是否可延伸水下机器人通信与数据处理？是否有相关预研或合作伙伴？公司芯片已进入国内车企钥匙系统，而无线 BMS、胎压监测等车载场景对低延时需求迫切。请问在新能源汽车智能化趋势下，是否计划推出车规级星闪/端侧 AI 集成芯片？如何评估单车芯片价值量提升空间？公司产品矩阵覆盖蓝牙、Matter、星闪等协</p>
--	---

	<p>议，且端侧 AI 芯片已支持主流模型移植。面对具身智能所需的感知-决策-执行闭环，是否会推出融合多协议通信与边缘 AI 的 SoC？这将如何增强在机器人市场的竞争力？公司已进入谷歌、亚马逊等头部生态，请问如何利用现有客户资源加速向机器人、深海等场景拓展？</p> <p>A4：星闪技术着眼于提升无线短距通信技术在时延、可靠性、同步精度、安全性等方面的演进需求，可以满足智能汽车、智能终端、智能制造、智能家居等市场需求。星闪技术 2024 年开始商业化落地，技术标准也演进到 2.0 版本。公司对于星闪技术也在持续投入，并完成关键技术的初步开发，后续将推出相关产品，以匹配高速的市场增长需求，公司会结合星闪技术的商业化进展从业务端、产品端予以跟进。</p> <p>公司产品的应用领域广泛，客户行业分散，目前主要覆盖电脑外设、智能家居、智能硬件、智能工业系统、智能商业系统等领域，针对您提及的人形机器人、具身智能、深海资源开发、海底观测网等领域，公司尚未形成规模化的应用或暂未涉足，公司接下来的经营规划还请参考公司已披露的内容。</p> <p>Q5：随着行业内众多企业纷纷加大在机器视觉和人工智能领域的研发投入，市场竞争日益激烈。公司当下如何看待当前人工智能及软件行业的竞争格局？最主要的竞争点是什么？</p> <p>A5：近年来，随着人工智能和大数据的快速发展，无线连接芯片行业迎来了新的增长机遇。特别是在物联网和智能设备领域，对高性能、低功耗芯片的需求不断增加。无线连接芯片的发展也呈现出以下新特点：一是芯片制造工艺的持续进步，先进的工艺不断涌现，使得芯片性能大幅提升、功耗显著降低；二是全球芯片产业链的重塑，国际贸易摩擦和地缘政治因素导致供应链的不确定性增加，各国纷纷加大对本土芯片业的扶持力度，推动产业的多元化和自主化发展；三是人工智能和机器学习技术的融合，为芯片设计带来了新的挑战和机会，芯片需要具备更强的计算能力和更高的能效比，以满足智能设备对实时数据处理的需求。</p> <p>细分来看，随着边缘人工智能（EdgeAI）的兴起，芯片设计需要支持边缘计算和人工智能功能。这要求芯片具备更强的计算能力和更高的能效比，并集成专用的 AI 加速模块，以实现高效的数据处理和机器学习算法的运行。同时，EdgeAI 还对芯片的实时性、低功耗和安全性提出了更高要求，以满足智能家居、智能办公、无线音频等领域的应用需求。</p>
--	--

	<p>2024 年，公司推出两款端侧 AI 芯片及全球功耗最低的智能物联网连接协议平台 TLEdgeAI-DK，集成了端侧计算单元与多协议无线通讯能力，具备全球领先的低功耗优势以及多维度的产品性能优势，为海量 AI 端侧应用的未来发展铺就崭新道路，进一步打开同时需要无线连接与边缘 AI 运算能力的高速增长的巨大市场，标志着公司正式步入“连接+算力”的 AIoT 时代，未来将推动公司业绩增长。</p> <p>Q6：无线物联网芯片行业市场竞争激烈，技术更新换代快。泰凌微在无线物联网芯片领域有一定技术积累，您认为当前行业的发展趋势是什么？泰凌微如何紧跟行业趋势，持续投入研发，提升产品性能和竞争力，以满足不同物联网应用场景对芯片的多样化需求？</p> <p>A6：在过去 25 年里，以 Wi-Fi、蓝牙、和 Zigbee 等为代表的短距离无线连接技术彻底改变了我们生活的世界。预计未来将形成一个庞大的互联设备生态系统。</p> <p>近年来，随着人工智能和大数据的快速发展，无线连接芯片行业迎来了新的增长机遇。特别是在物联网和智能设备领域，对高性能、低功耗芯片的需求不断增加。无线连接芯片的发展也呈现出以下新特点：一是芯片制造工艺的持续进步，先进的工艺不断涌现，使得芯片性能大幅提升、功耗显著降低；二是全球芯片产业链的重塑，国际贸易摩擦和地缘政治因素导致供应链的不确定性增加，各国纷纷加大对本土芯片业的扶持力度，推动产业的多元化和自主化发展；三是人工智能和机器学习技术的融合，为芯片设计带来了新的挑战和机会，芯片需要具备更强的计算能力和更高的能效比，以满足智能设备对实时数据处理的需求。</p> <p>公司在 2024 年升级了使命“提供绿色、安全、可靠的超值产品，实现万物轻松互联”，并确立了新的价值观“客户至上，品质卓越，结果导向，主动承担，务实创新，合作共赢”。基于此，2025 年，公司将持续研发具有自主知识产权且达到国际一流水平的低功耗无线物联网系统级芯片，以满足市场需求、赢得客户认可。具体来看，泰凌微将进一步拓展 BLE 垂直市场至高端游戏配件和智能电动车领域，并保持蓝牙音频产品的高增长势头，同时推动 WiFi 产品的批量出货。公司将持续加速内部研发进程，加大对 AI 技术的应用布局，增强在 22nm 和 40nm 工艺上的产品矩阵，完善 IoT 和音频芯片系列，并不断优化成本结构。</p> <p>Q7：在物联网市场快速发展的背景下，物联网应用场景不断拓展，对芯片的功耗、成本、集成度等方面提出了更高要求。泰凌微如何在产品研发和生产过程中，优化技术方</p>
--	--

	<p>案，降低成本，提高产品性价比，以适应市场需求的变化，在市场竞争中占据优势地位？</p> <p>A7：公司持续推动芯片研发，大幅加快产品节奏。公司在2024年完成22nm、40nm等新工艺多个IOT和音频芯片的量产流片，并持续在55nm等现有工艺平台上进行产品迭代和提升。2024年公司多个新产品推向市场，快速更新产品在IOT和音频上的布局，为后续持续成长打好了基础。同时，公司在蓝牙高速率（HDT）、星闪标准（Sparklink/NearLink）等多模无线标准的开发上积极布局，并开始集成到新芯片中，也将在后续产品中逐步发布。公司依托多年研发形成的RISC-V芯片深厚基础，加快RISC-V架构芯片的布局，覆盖从高端到低端多种层次市场定位。另外一方面持续针对细分市场进行更精准的产品定义和迭代，提供更具竞争力的芯片和软件产品。</p> <p>另外，公司推出TL721X系列芯片产品和机器学习与人工智能发展平台TLEdgeAI-DK，支持主流本地端AI模型，如谷歌LiteRT、TVM等开源模型。TL721X系列也是目前世界上功耗最低的智能物联网连接协议平台，特别适合运用在需要电池供电的各类产品，为海量AI端侧应用的未来发展铺就崭新道路。</p> <p>Q8：长期以来，公司重视内生技术突破，研发投入大，2024年研发费用达2.02亿元，目前，证监会大力支持科创板并购重组，上海也出台了支持上市公司并购重组的行动方案，对此，请问盛总，公司对于内生技术突破与并购外延扩张两者之间的平衡如何考量？公司是否会留意合适的并购机会来补强端侧AI算法技术、客户资源或海外渠道以提升公司的业绩？</p> <p>A8：公司会以主营业务为中心，寻求合适的外延发展机会，扩大公司规模，提高公司综合竞争力，充分发挥上市公司的平台作用。</p> <p>Q9：国际星闪联盟与机器人技术委员会共同推动“具身智能机器人+星闪”产业化融合发展，泰凌微星闪技术在具身智能机器人这一领域的技术适配性如何？泰凌微星闪芯片预期在2025年上半年上市，具身智能机器人这一新的应用场景能否为星闪芯片带来新的增量市场？</p> <p>A9：星闪技术作为新一代短距无线通信技术，以其超低时延、超高可靠性和精准同步等特性，在智能汽车、智能终端、智能家居等多个领域展现出广阔的应用前景。</p> <p>泰凌微作为星闪联盟的早期成员，自加入以来，一直紧密追踪星闪标准的进展，并持续投入相关研发与测试。目前，公司已完成星闪的核心功能测试，且将这些技术整合</p>
--	---

	<p>到了多模系统级芯片 TL752X 以及在研的多个芯片产品中。公司芯片目前尚未应用于具身智能机器人，公司会积极密切关注前沿领域的增量市场机会。</p> <p>未来，泰凌微将继续深耕物联网芯片领域，加大研发投入，与各方携手，共同推动星闪技术的进一步发展和普及。</p> <p>Q10：目前众多芯片企业陆续披露 2024 年年报和 2025 年一季度预报，泰凌微和一众同行在端侧 AI 领域的业绩都有不俗表现，您作为资深专业人士，是如何看待当前端侧 AI 芯片的技术生命周期阶段（如导入期/成长期）？未来 3 年该领域的生命周期如何？</p> <p>A10：做端侧 AI 的重要原因是在很多应用场景中，人们不希望将大量数据传输到云端进行运算来获得 AI 支持。将数据传到云端虽可获得更大算力支持，但存在诸多问题，如需要更宽的传输带宽、消耗端侧更多功耗、存在延时降低用户体验以及数据泄密和个人隐私暴露等风险。在很多 AI 应用中，在各种端侧产品本地实现全部或者部分 AI 功能可将传到云端的数据量压到最低，从而提高反应时间、提升用户体验、降低功耗、保护隐私等，而且在没有网络的情况下仍然可以使用 AI 功能。端侧 AI 在智能家居、智能音频、智慧医疗、位置服务定位、工业传感等领域已有很多落地机会，后续对端侧 AI 的需求会越来越多。</p> <p>目前公司端侧 AI 已量产的第一个项目是音频类产品，芯片已开始出货，预计今年上半年客户产品上市，是国内头部音频类客户采用。同时，还有多个端侧 AI 项目在进行，包括智能穿戴、运动监测类产品、电动工具、追踪器、汽车防盗器以及基于 Matter 标准的智能家居产品等。</p> <p>未来几年，端侧 AI 带来的新市场机会会陆续落地，有望为公司带来长期增长机会。</p> <p>Q11：易方达、华夏等头部公募 2025 年明显加仓“AI+半导体”组合（如海光信息、中芯国际），公司是否有针对性制定头部公募覆盖计划？例如是否考虑引入具备公募资源的战略股东优化股东结构？是否会加强与头部公募的定制化沟通？以芯原股份为例，其 2023 年通过“技术开放日+细分赛道市占率数据高频披露”等方式，成功吸引华夏、汇添富等头部公募的投资，泰凌微是否会参考此类标杆案例完善投关策略？</p> <p>A11：公司自上市以来一直高度重视投资者关系管理工作的质量，建立多元化投资者沟通交流渠道，通过接听投资者热线、投资者关系邮箱、上证 E 互动、开设企业官网投资者关系专区、组织业绩说明会和股东会等方式，积极与</p>
--	--

	<p>投资者互动交流，回应投资者关切，及时、准确向投资者传递公司经营发展信息，促进各类投资者如公募基金、私募基金、个人等类型的投资者对公司价值的认同和信心，与投资者建立良好互动。切实保障投资者的知情权，传递公司经营发展信息，为股东提供准确的投资决策依据。</p> <p>2025 年，公司将继续加强投资者沟通交流，积极建立与资本市场的有效沟通机制，持续打造健康、透明的投资者关系管理体系，不断完善沟通渠道，丰富交流方式，积极响应股东合理诉求，充分回应市场关切，消除信息壁垒，让投资者能够更加透彻、清晰、全面地知悉并了解公司价值，增强投资者对公司的认同感和信心。</p>
上传日期	2025 年 4 月 30 日